

SpheroX[®] 24kit 超低粘附 24 孔平底孔板套装

使用说明书（试行版）

适用产品 Catalog : EFL-SP201

SpheroX[®] 24kit 孔板套装是 EFL 推出的超低粘附孔板。该产品通过纳米包被技术在孔板表面形成超薄亲水涂层，显著降低蛋白吸附，使细胞无法进行贴壁生长。

SpheroX[®] 产品所具有的超低粘附表面可用于细胞球体、类器官等应用研究，也可用做 3D 支架及微载体的细胞接种培养。

产品组分

组分	性状	规格	备注
24 Well Cell Culture Plate	平底	4 块	无菌产品
Anti-adherent Coating Solution	无色透明液体	50 mL	

储存条件

室温； 生产日期及有效期见包装。

孔板包被处理

1. 向 **SpheroX[®] 24kit** 孔板中加入抗粘附包被液；(200~300 μ L/孔, 加液时避免出现气泡)
2. 将孔板放入二氧化碳培养箱静置不少于 10min；(静置过夜效果更佳)
3. 取出培养板，吸弃包被液后即可进行细胞接种。(完全移除液体)

关于 3D 支架、微载体、微球的细胞接种培养

将支架载体放入包被好的孔板后接种细胞，**SpheroX[®] 24kit** 极低的粘附性可阻碍细胞向孔板迁移，显著提高支架的细胞接种效率。

